

2011年3月期 通期決算概要

ルネサス エレクトロニクス株式会社

2011年5月18日

代表取締役社長 赤尾 泰

© 2011 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

本日はご多忙のところお集まりいただき、ありがとうございます。

2011年3月期 通期の決算概要について、お手元にお配りしてございますプレゼンテーションにそって、ご説明してまいります。

(本プレゼンテーションに関する注意)

本資料における前連結会計年度(2010年3月期)の業績数値は、旧NECエレクトロニクス(株)と旧(株)ルネサス テクノロジ(以下、旧両社)の前連結会計年度の業績数値を単純合算したものであります。なお、「売上高」および「半導体売上高」については、旧NECエレクトロニクス(株)の表示方法と整合させるために旧(株)ルネサス テクノロジについて一部組替表示しております。

(将来予測に関する注意)

本資料に記載されているルネサス エレクトロニクスグループの計画、戦略および業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づきルネサス エレクトロニクスグループが判断しており、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、実際の業績等は、様々な要因により、これら見通し等とは大きく異なる結果となりうることをあらかじめご承知願います。実際の業績等に影響を与える重要な要因としては、(1)ルネサス エレクトロニクスグループの事業領域を取り巻く日本、北米、アジア、欧州等の経済情勢、(2)市場におけるルネサス エレクトロニクスのグループ製品、サービスに対する需要動向や競争激化による価格下落圧力、(3)激しい競争にさらされた市場においてルネサス エレクトロニクスグループが引き続き顧客に受け入れられる製品、サービスを供給し続けていくことができる能力、(4)為替レート(特に米ドルと円との為替レート)の変動等がありますが、これら以外にも様々な要因があります。また、世界経済の悪化、世界の金融情勢の悪化、国内外の株式市場の低迷等により、実際の業績等が当初の見通しと異なる結果となる可能性もあります。

エグゼクティブ・サマリー

I. 2011年3月期 通期 決算概要

- 震災影響等により売上高は前回想定を下回ったものの、構造対策の着実な実行や統合シナジー効果などにより、通期営業黒字を達成
- 構造対策の実行に加え、東日本大震災の影響などにより1,182億円の特別損失を計上

II. 東日本大震災の影響と復旧に向けて

- 那珂工場の早期復旧や代替生産等により製品供給の最大化を実現
- 震災の影響をふまえた投資の抑制、費用の削減等の実行

こちらが本日のご説明内容のサマリーでございます。

1つ目が、2011年3月期 通期の決算概要となります。

売上高は震災の影響などにより、前回3Qの決算時に申し上げた想定を下回ったものの、構造対策の着実な実行や統合シナジーの効果などにより、統合初年度の大きな目標であった通期での営業黒字を達成いたしました。

また、従来より申し上げていた構造対策の実行に伴う特別損失に加え、東日本大震災の影響による特別損失が発生したことなどにより、1,182億円の特別損失を計上いたしました。

2つ目が、東日本大震災の影響と復旧に向けての対応となります。

プレスリリースなどで随時お知らせしておりますが、特に被害の大きかった那珂工場についての対応、さらに、震災の影響をふまえた当社の取り組みにつきまして、後ほど詳しくご説明させていただきます。

I. 2011年3月期 通期 決算概要

それではまず、2011年3月期 通期の決算概要についてご説明いたします。

2011年3月期 決算概要

- 統合初年度の経営目標であった通期営業黒字を達成
- 構造対策の実行に加え、東日本大震災の影響による特別損失を計上

(単位:億円)	2011年3月期				
	第4四半期	前四半期比	通期	前回予想比	前期比
売上高	2,753	+1	11,379	△121	+755
半導体売上高	2,495	+50	10,189	△111	+764
営業損益	104	+70	145	+75	+1,278
経常損益	78	+67	10	+60	+1,264
当期純損益	△562	△386	△1,150	△350	+228
1US\$=	83円	±0円	86円	-	-
1ユーロ=	111円	1円高	114円	-	-

注)前期比は、旧両社の合算値もしくは一部組み替え後の数値からの比較を記載

まず、実績のサマリです。

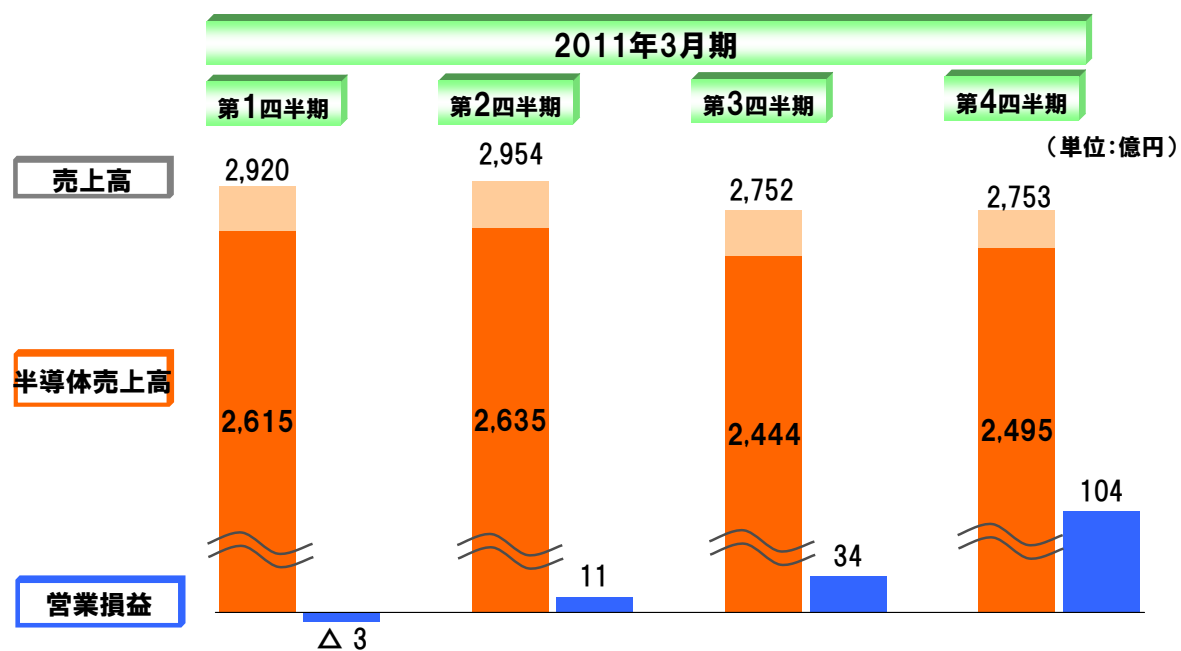
第4四半期につきましては、前四半期との比較で、半導体売上高が50億円の増収、営業利益は70億円の増益となりました。

通期につきましては、営業利益が前回想定を大きく上回る145億円の黒字、経常利益段階においても通期での黒字化となりました。当期純損益については、冒頭お話ししましたとおり、構造対策の実行に加え、震災の影響による特別損失を計上したことなどにより、1,150億円の赤字となりました。

詳細につきましては、次ページ以降でご説明してまいります。

2011年3月期 四半期決算概要

■ 営業損益は四半期毎に改善傾向



四半期ごとの業績ですが、売上は日本国内の市場環境により、下期は減速しましたが、営業損益は、主に構造対策および統合シナジーにより四半期ごとに改善いたしました。

2011年3月期 半導体売上高の事業別状況

■ マイコンとアナログ&パワー半導体事業は、前期(2010年3月期)比で半導体売上高全体の伸びを上回る増収を達成

(単位:億円)	2011年3月期		通期
	第4四半期	前四半期比 (%)	
半導体売上高 計	2,495	+2%	10,189
マイコン	950	+1%	3,841
アナログ&パワー半導体(A&P)	770	+6%	3,162
SoC	747	△2%	3,117
その他半導体	27		69

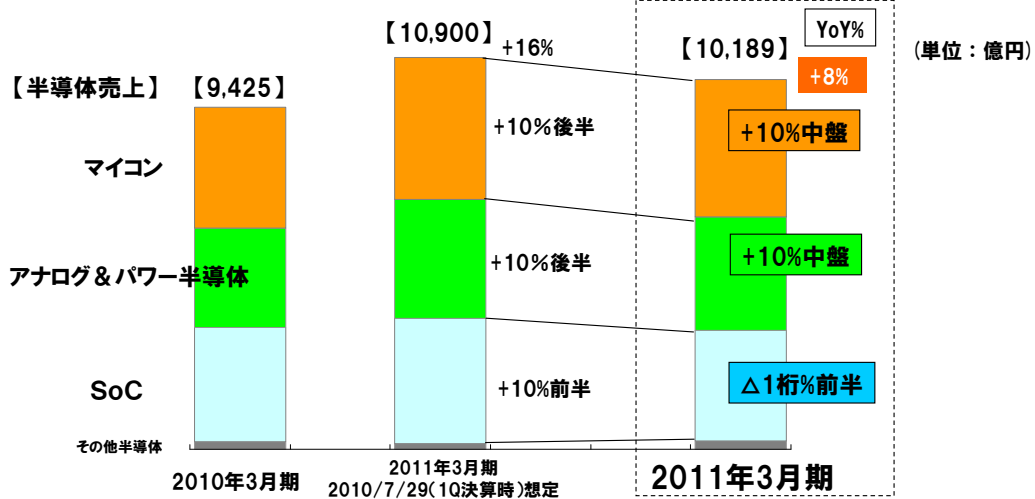
7ページは、第4四半期および通期の事業別の半導体売上高です。

第4四半期につきましては、第3四半期との比較で、特にアナログ&パワー半導体の売上が増加いたしました。

通期につきましては、マイコンとアナログ&パワー半導体の売上が、前期比で半導体売上高全体の伸びを上回る増収となりました。8ページおよび9ページで、詳細をご説明いたします。

2011年3月期 半導体売上高の事業別状況

- 海外市場は中国を始めとする新興国での需要が自動車やスマートフォン向けカメラLSI、表示ドライバ向けに堅調
- 国内市場は上期後半以降、自動車・民生分野の需要減に加え、国内フィーチャーフォン向け通信LSIが不振
- 円高の進行(1ドル想定90円が86円)により約160億円の減収要因



8 © 2011 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

RENESAS

まず、8ページは、通期の半導体売上高実績について、前期の実績および昨年7月時点での想定との対比を、棒グラフで示したものです。

一番左の棒グラフが前期の実績、真ん中が通期の想定値、右が通期実績です。

事業別でみると、マイコンおよびアナログ&パワー半導体については想定比若干の下ぶれにとどまったものの、SoCにつきましては、2桁%の増収見込みから一転、減収となりました。

状況を地域別で申し上げますと、

海外市場については、中国をはじめとする新興国での需要を中心に、自動車向けマイコンやパワー半導体、スマートフォン向けカメラLSI、中小型向け表示ドライバなどが堅調に推移いたしました。

一方、国内市場については、上期後半以降、自動車・民生分野における需要減に加え、国内フィーチャーフォン向け通信LSIが不振となりました。

また、昨年7月時点での想定との比較においては、先に述べた市場環境に加えて、円高の進行による売上減もありました。

2011年3月期 半導体売上高の事業別状況

	分野対前期増減	対前期増減主要因
<p>マイコン 通期 売上高</p> <p>自動車 約45%</p> <p>汎用 約55%</p>	自動車分野 ↑ 汎用分野 ↑	> 統合後も自動車分野向けW/W高シェアを堅持 > 中国をはじめとする新興国の産業・民生機器市場好調。売上大幅増
<p>化合物半導体 約15%</p> <p>パワー半導体 & アナログIC 約65%</p> <p>表示ドライバIC 約20%</p> <p>半導体通期 売上高</p>	パワー半導体 & アナログIC ↑ 表示ドライバIC ↓	> 新興国における自動車市場の拡大及び電装化率増によりパワー半導体 & アナログIC売上増 > 表示ドライバICはスマートフォン市場の拡大により小型パネル向けは売上増、大型パネル向けは苦戦
<p>自動車 約10%</p> <p>モバイル分野 約35%</p> <p>産業分野 約10%</p> <p>PC周辺 約15%</p> <p>民生機器 約30%</p> <p>SoC 通期 売上高</p>	モバイル分野 ↓ 民生分野 ↓ PC周辺分野 ↓ 産業分野 ↑ 自動車分野 ↑	> モバイル分野はスマートフォン向けカメラLSI売上増も、国内フィーチャーフォン市場伸び悩みで、通信LSI売上大幅減 > PC周辺(HDD、光ディスク向け)向け市場減速により売上減

9 © 2011 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

RENESAS

9ページは、通期の各事業別の売上について、さらに分野別での状況を示したものです。

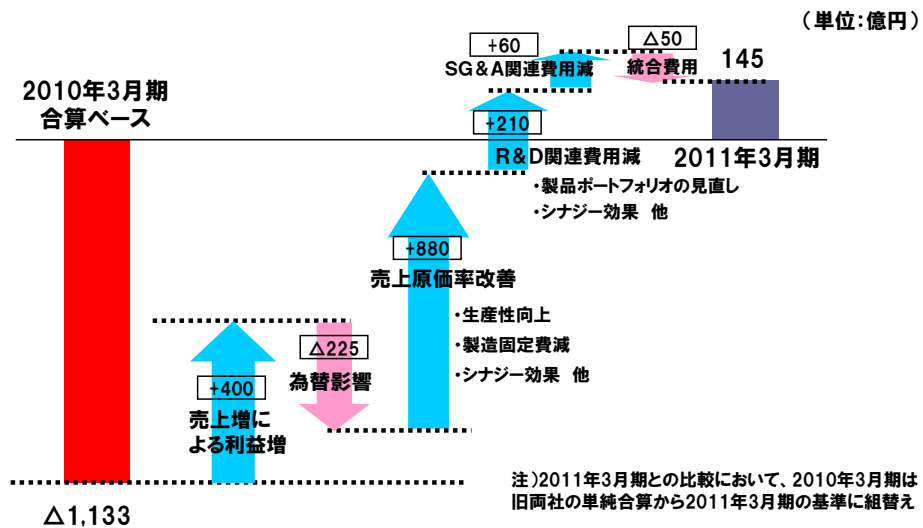
マイコンにつきましては、自動車向け、汎用向けとも前期比増収となり、特に中国をはじめとする新興国の、産業・民生機器向けが好調に推移いたしました。

アナログ&パワー半導体は、パワー半導体やアナログICが、新興国における自動車市場の拡大や電装化率の増加などにより、前期比で増収となりました。

SoCは、モバイル分野における国内フィーチャーフォン向け通信LSIや、パソコン市場の減速によるPC周辺向けLSIが、前期比で大幅減収となりました。

2011年3月期 通期営業損益の増減分析(対前期比)

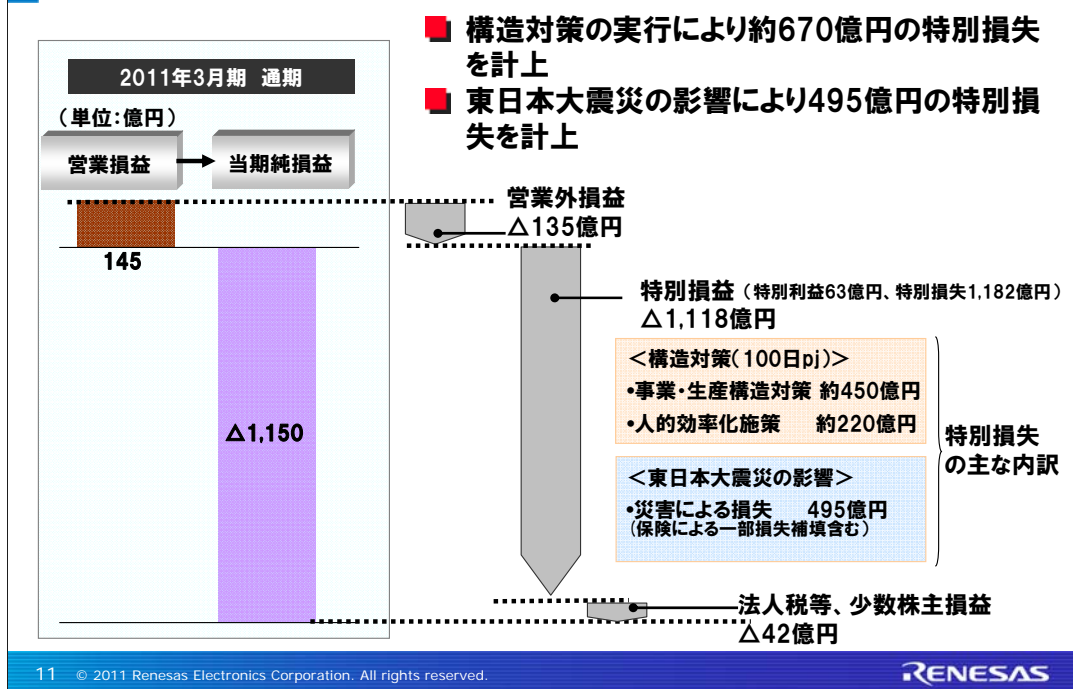
■ 売上増に加えて、生産性の向上に伴う売上原価率の改善や、設備投資の抑制等による減価償却費の削減、製品ポートフォリオの見直し等による研究開発費の抑制などにより、通期営業黒字を達成



こちらのページは、通期の営業損益について、前期からの増減要因をエレベーターチャートにて示したものです。

前期は、合併前の2社の合算ベースで1,133億円の営業赤字でありましたが、プレゼンテーションに示しておりますとおり、売上増に加えて、生産性の向上に伴う売上原価率の改善や、設備投資の抑制などによる減価償却費の削減、製品ポートフォリオの見直しなどによる研究開発費の抑制などにより、1,278億円営業利益が改善し、通期の営業黒字を達成いたしました。

2011年3月期 当期純損益の状況



11ページは、通期の当期純損益の状況について、営業利益からの増減を示したものです。

「100日プロジェクト」で策定した構造対策プランに従い、特別損失を約670億円計上したことに加え、東日本大震災の影響により495億円の特別損失を計上いたしました。

それぞれの特別損失の詳細につきましては、のちほどご説明させていただきます。

これらの結果、通期の当期純損益は1,150億円の赤字となりました。

100日プロジェクト進捗状況 ①成長戦略

～事業ポートフォリオの最適化～

	主な施策
マイコン事業	<ul style="list-style-type: none"> ・プロセス・CPUコア・周辺IPなどを片寄せ・統合 ・新興国、特に中国の需要を取り込むべく、中国の販売子会社に現地社員をトップとする事業推進組織を新設 ・中国向けに1,000製品を開発(2012年までに)
アナログ&パワー半導体事業	<ul style="list-style-type: none"> ・両事業のマーケティング機能を一体化し、市場、特に海外に対する直接的な働きかけを強化 ・自動車及び電源分野を中心とした製品ラインアップ・キットソリューションを拡充 ・低耐圧から高耐圧までのパワー製品ラインアップの強化(3年間で1,000製品投入)
SoC事業	<ul style="list-style-type: none"> ・グローバル市場で大きな拡大が見込まれるLTEモデムプラットフォーム事業を推進するため、NOKIA社からLTEモデム技術を導入しルネサスモバイルを設立 ・産業/通信等の社会インフラを注力分野と定め、リソースを集中

続きまして、「100日プロジェクト」で策定した3つの柱につきまして、主な施策のここまでの進捗状況についてご説明いたします。

まず、こちらのページでは、成長戦略についてご説明いたします。
事業別に主な施策を申し上げますと、

マイコンについては、2社が合併したことにより重複したプロセスやCPUコア、周辺IPなどの片寄せ、統合を推進いたしました。また、成長が期待される中国市場への取り組みとして、現地社員をトップとするマーケティング組織を新設するとともに、3年間で中国市場向けに1,000製品を開発することを決定いたしました。

アナログ&パワー半導体については、自動車や電源分野向けの製品ラインナップ、キットソリューションの拡充を進めました。
また、世界ナンバーワンシェアのマイコンを強みに、アナログ&パワー半導体とのシナジーをより発揮するため、両事業のマーケティング機能を一本化し、特に海外市場に対する直接的な働きかけを強化いたしました。

SoCについては、産業、通信などの社会インフラを注力分野と定め、注力分野へのリソース集中を一層推進いたしました。特に、モバイル分野については、ノキアよりLTEモデム技術を導入しルネサスモバイルを設立、モデム技術を武器に、携帯電話のみならず、グローバル市場で大きな拡大が見込まれるコンバージェンス市場への取り組みを強化いたしました。

100日プロジェクト進捗状況 ②統合シナジー実現

	主な施策
販売	<ul style="list-style-type: none"> ・国内特約店商流の絞込みと強化【30⇒16社、10年度3Q完】 ・国内外販売拠点の統合【38⇒16拠点、10年度3Q完】
設計・開発	<ul style="list-style-type: none"> ・マルチメディアSoCの共通プラットフォームを導入【10年度3Qに第1弾製品(R-Car)を発表】 ・ローエンドマイコンのCPUコアを統合(5⇒4CPUコア)【10年度4Qに新コア第1弾製品(RL78)のサンプル出荷開始】 ・旧両社製品・技術の徹底したベンチマークにより製品・技術ロードマップを統合【28nm以降の先端プロセスのR&Dを一本化】 ・開発環境を統合し設計費用削減
生産	<ul style="list-style-type: none"> ・ファブネットワーク構築、ファウンドリ・サブコンの活用、生産固定費の機動的な抑制等による変動対応力の強化 ・チップサイズ縮小、PKG小型化、テスト時間短縮
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・物流、倉庫、情報システムなどの統合

次に、統合シナジーの実現の主な施策についてご説明いたします。

まず、販売面については、合併により重複した国内外販売拠点の統合や、国内特約店商流の絞込みと強化を、合併1年以内で完了いたしました。

次に、設計・開発面については、SoCにおいて共通プラットフォームを導入するとともに、マイコンについては、合併初年度にローエンドコアの統合を決定いたしました。さらに、28nm以降の先端プロセスのR&Dの一本化も決定いたしました。

さらに、生産面については、ファブネットワークの構築、ファウンドリ・サブコンの活用、生産固定費の機動的な抑制などによる変動対応力の強化を推進するとともに、チップサイズの縮小や、パッケージの小型化、テスト時間の短縮など、旧両社のベンチマークによる生産効率の改善を図りました。

その他、物流、倉庫、情報システムなどの統合も推し進めました。

100日プロジェクト進捗状況 ③構造対策実行

■ 想定を下回る損失・費用となった施策があったことなどにより、特別損失の計上額が想定比で約100億円減少しているが、構造対策の進捗はほぼ予定どおり

	主な施策
事業・生産構造対策 約450億円 (前回想定:約530億円)	<ul style="list-style-type: none"> ・鶴岡、ローズビル工場の減損 ・ローズビル工場の売却 ・滋賀(5インチ閉鎖予定)、福岡(閉鎖予定)、高知(一部貸与)など生産ラインの再編
人的効率化対策 約220億円 (前回想定:約240億円)	<ul style="list-style-type: none"> ・早期退職優遇制度の実施(3/31付 計1,487名) ・販売特約店や大株主3社などへの転出(約700名) ・生産構造対策に伴う人的効率化(ローズビル売却 約600名など) ・注力分野への社内シフト(約1,000人規模)
計 約670億円 (前回想定:約770億円)	

14ページは、構造対策の実行についての主な施策と、特別損失の計上額についてでございます。

まず、事業・生産構造対策につきましては、第一四半期において山形・鶴岡工場の300mmラインとアメリカ・ローズビル工場の減損を実施し、さらにローズビル工場については、今年3月に売却を決定いたしました。

また、国内の複数の拠点における生産ラインの再編を推進いたしました。これらの施策により、約450億円の特別損失を計上いたしました。

次に、人的効率化対策につきましては、早期退職優遇制度の実施や、販売特約店、大株主3社などへの転出、生産構造対策に伴う人的効率化などに加えて、注力分野への社内シフトも推し進めました。

これらの施策により、約220億円の特別損失を計上いたしました。

前回まで、「100日プロジェクト」における構造対策の実行により、約770億円の特別損失が発生する見込みである旨、申し上げてまいりましたが、想定を下回る損失・費用となった施策があったことなどにより、特別損失の計上額が想定比で約100億円減少いたしました。しかしながら、構造対策の実行はほぼ予定どおり進捗しており、これは震災後も変わっておりません。

バランスシートの状況

(単位:億円)	10/4期首 (増資後)	10/12末	11/3末
総資産	12,154	11,513	11,450
うち 現金および現金同等物	3,377	3,343	3,373
うち たな卸資産	1,266	1,440	1,234
負債合計	8,017	8,084	8,540
うち 有利子負債	3,720	3,667	3,782
株主資本	4,210	3,622	3,060
純資産合計	4,136	3,429	2,911
D/Eレシオ(グロス)	0.91倍	1.09倍	1.33倍
D/Eレシオ(ネット)	0.08倍	0.09倍	0.12倍
自己資本比率	33.5%	29.2%	24.8%

(注1)①現金および現金同等物:「現金および預金」と「有価証券」の単純合算値から「預入期間が3か月を超える定期預金」を控除しております。
 ②有利子負債:「短期借入金」、「1年内返済予定の長期借入金」、「1年内償還予定の新株予約権付社債」、「リース債務」、「新株予約権付社債」、「長期借入金」
 ③自己資本:「株主資本」、「その他の包括利益累計額」
 ④D/Eレシオ(グロス):有利子負債/自己資本
 ⑤10/4期首(増資後)の負債合計には、負ののれん22億円を便宜的に含めております。
 (注2)「10/4期首(増資後)」の数値は、当連結会計年度期首の数値に2010年4月1日付の企業結合に係る会計処理および同日付の第三者割当増資約1.346億円を反映した数値です。

続きまして、15ページは、バランスシートの状況であります。

たな卸資産の残高が昨年12月末から3月末にかけて約200億円減少しておりますが、これは、震災の発生に伴う生産ラインの停止などにより、当社製品在庫や販売子会社の在庫、仕掛品が減少したことや、震災によるたな卸資産の滅失が発生したことなどによるものです。

一方、構造対策の実行や震災による特別損失の計上などにより、1,150億円の当期純損失を計上した結果、株主資本が大幅に減少し、自己資本比率が約25%となりました。しかしながら、現金および現金同等物の残高は増資後の期首からほとんど変わっておらず、ネット・デット・エクイティ・レシオは0.12倍と低い水準を維持しております。

キャッシュ・フローの状況

■ 設備投資の抑制などにより、通期のフリー・キャッシュ・フローは黒字を確保

(単位：億円)	2011年3月期				
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	通期
営業活動による キャッシュ・フロー	△20	350	539	156	1,025
投資活動による キャッシュ・フロー	△144	△184	△390	△240	△958
フリー・ キャッシュ・フロー	△164	166	150	△84	67

16ページは、キャッシュ・フローの状況であります。

通期のフリー・キャッシュ・フローにつきましては、設備投資の抑制などにより、黒字を確保いたしました。

II. 東日本大震災の影響と復旧に向けて

次に、3月11日に発生いたしました東日本大震災の影響と、震災からの復旧に向けた当社の取り組みについてご説明いたします。

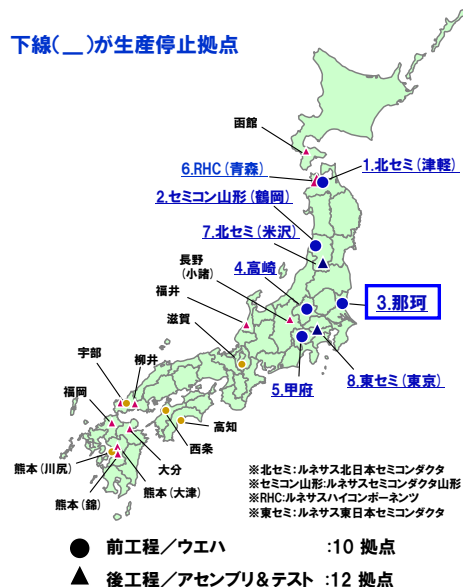
震災により生産停止した拠点と復旧状況

- 那珂工場を除き、生産停止した拠点は全て生産再開
- 那珂工場についても、6月から一部限定能力にて生産再開（ウエハ投入）予定

<生産停止した拠点と復旧状況>

	拠点	稼働状況	主な生産品目
前 工 程	1. 北セミ(津軽)	生産再開	車載用マイコン
	2. セミコン山形(鶴岡)	生産再開	汎用IC SoC
	3. 那珂	停止中 6月一部 生産再開予定	車載マイコン、汎用マイコン 汎用IC SoC
	4. 高崎	生産再開	パワーデバイス、アナログIC
	5. 甲府	生産再開	パワーデバイス、アナログIC
後 工 程	6. RHC(青森)	生産再開	汎用IC
	7. 北セミ(米沢)	生産再開	車載マイコン、汎用マイコン
	8. 東セミ(東京)	生産再開	RF ICs

下線()が生産停止拠点



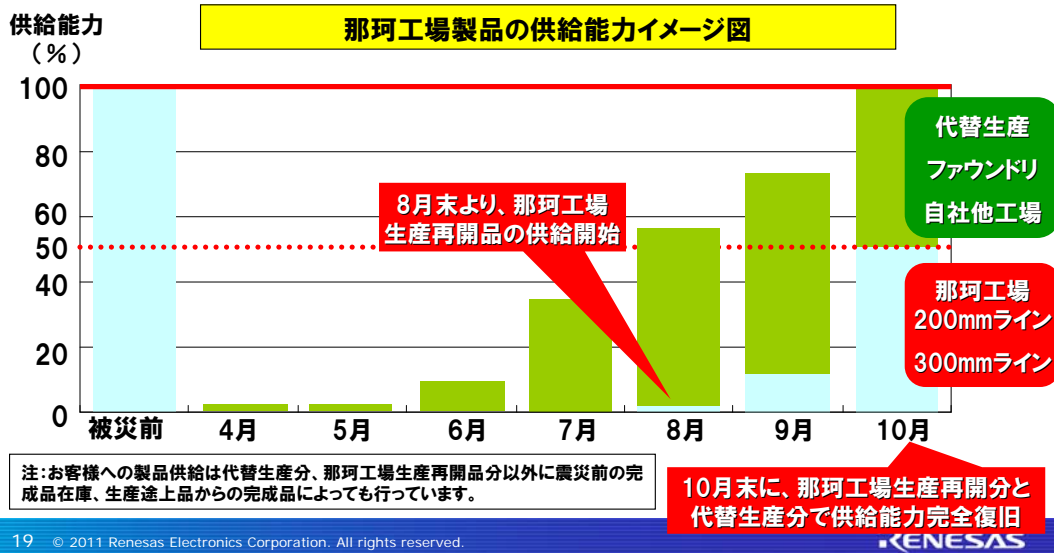
こちらのページは、震災により生産停止した拠点と復旧状況について示したものです。

当社グループでは、前工程工場5拠点および後工程工場3拠点で生産の停止を余儀なくされましたが、当社グループ一丸となった復旧作業および社外関係者の方々からの多大なるご支援により、最も大きな被害を受けた那珂工場を除き、すでに通常の生産体制に復旧しております。また、那珂工場についても、2011年6月初めから一部限定能力での生産を再開する予定となりました。

次のスライドにて、那珂工場の復旧および代替生産計画について、詳細をご説明いたします。

那珂工場の復旧、代替生産計画

- 被災前に那珂工場で生産していた製品について、まずはお客様への製品供給の充足(供給能力100%)を最優先に、那珂工場を復旧
- 10月末には、那珂工場生産再開分と代替生産(ファウンドリ+自社他工場)を合わせて、供給能力100%に回復)



こちらが、那珂工場の復旧計画と、当社グループの別工場およびファウンドリでの代替生産計画について、イメージ図で示したものです。

被災前に那珂工場で生産していた製品については、お客様への製品供給の充足を最優先に、那珂工場の生産再開による製品供給と、代替生産による製品供給を並行して進めることにより、本年10月末には、那珂工場の生産再開分と代替生産分を合わせて、供給能力100%、すなわち被災前の供給能力に回復する見込みとなっております。

なお、お客様への製品供給は、こちらのグラフでお示している那珂工場の生産再開分と代替生産分以外に、震災前の完成品在庫、生産途上品からの完成品によっても行っております。完成品在庫や生産途上品で5月まではある程度カバーできるものの、6月以降は被災前の那珂工場の製品について、供給不足にならざるを得ない状況であり、ご理解をいただくよう引き続きお客様への説明を続けております。さらに、那珂工場の生産再開を当初計画より前倒ししているとおり、お客様へいち早く製品供給できるよう尽力しております。

ファブネットワークの推進を加速

- 今回の震災を教訓に、需要変動や突発的な事象に対するさらなる変動力強化として、統合後行ってきたファブネットワークを一層推進
- ファブネットワークを前提とした製品開発の促進により、ファブネットワークを強化

<那珂工場におけるファブネットワーク例>

那珂工場	主要代替先	
	自社他工場	ファウンドリ
200mmライン	<ul style="list-style-type: none"> ・ルネサス北日本セミコンダクタ 津軽工場 ・西条工場 	<ul style="list-style-type: none"> ・グローバルファウンドリーズ
300mmライン	<ul style="list-style-type: none"> ・ルネサス山形セミコンダクタ鶴岡工場 ・西条工場 	<ul style="list-style-type: none"> ・TSMC

被災前の那珂工場
生産製品の約半分を
代替生産

20ページは、今回の震災を踏まえたファブネットワークの今後の方針について示したものです。

従前より、ファブネットワークを推進してまいりましたが、今回の震災を教訓に、需要変動や突発的な事象に対するさらなる変動力強化として、ファブネットワークを一層推進してまいります。

今後も、ファブネットワークを一層推し進め、機動的な生産体制を構築することにより、変動対応力を持ち、安定した成長を実現する強靱な企業体質の構築に努めてまいります。

なお、こちらのページの表は、那珂工場におけるファブネットワーク例を示しておりますが、今回の震災後において、被災前の那珂工場生産製品の約半分を、複数の自社他工場やファウンドリで代替生産しております。

東日本大震災による影響

- 震災による損失見積額は655億円。保険による損失補填見込額160億円を差し引き、2011年3月期に震災による特別損失を495億円計上

<内訳>	<金額>
固定資産の修繕費(原状回復費用)	431億円
たな卸資産廃棄損	73億円
固定資産の廃棄損	62億円
操業休止の固定費(不稼働損失)	59億円
リース解約損失、その他	30億円
震災による損失 計	655億円
未収受取保険金	△160億円
震災による特別損失 計	495億円

うち、那珂工場
における損失が
全体の約85%

続きまして、今回の震災による特別損失の詳細について、ご説明いたします。

スライドに示しておりますとおり、損失の7割近くを占める原状回復のための固定資産の修繕費を中心に、資産の廃棄損や不稼働損失などが発生いたしました。

これらの結果、震災による損失見積額は655億円となったものの、保険による補填が160億円見込まれることから、2011年3月期において震災による特別損失を495億円計上しております。

東日本大震災による影響

■ 今後の業績への影響を最小限にとどめるべく、全力を挙げてあらゆる施策を実行

業績への影響

□ 売上(生産)面

- ✓ 生産ラインの稼働停止による影響
- ✓ 原材料・部品の調達による影響
- ✓ 震災影響による市場の不透明感

□ 利益面

- ✓ 売上(生産)減による利益減
- ✓ 復興関連費用の発生
- ✓ 不稼働損失

対応策

<短期的施策>

- ・売上減の影響最小化
(那珂工場早期復旧、代替生産)
- ・設備投資の抑制
- ・研究開発費の効率化
- ・あらゆる費用(経費)の削減
- ・必要資金の確保

<中期的施策>

- ・事業構造対策の更なる推進
- ・BCP(事業継続計画)の総点検

こちらのページには、今回の震災による業績への影響と、その対応策について示しております。

まず、売上や生産への影響といたしましては、生産ラインの稼働停止や稼働減による影響に加えて、原材料などの調達や震災影響による市場の不透明感などが要因としてあげられます。

また、利益への影響といたしましては、売上や生産減による利益減に加えて、復興関連費用の発生や、引き続き生産ラインの停止に伴う不稼働損失の発生が想定されております。

これらの影響に対する対応策として、売上減の影響最小化に向けた那珂工場の早期復旧と代替生産の施策については、先ほどご説明したとおりでございますが、そのほかにも、設備投資の徹底的な削減、研究開発費の一層の効率化、さらに緊急措置として、生産固定費をはじめとしたあらゆる費用の抑制を行ってまいります。

さらに、従来から取り組んできた収益事業への集中を一層加速し、売上規模の拡大に依存しない強固な事業構造の構築を図るとともに、今般の大震災を踏まえ、BCPの内容全般について点検と拡充を行い、有事の際でも、お客様への製品供給を早期に再開し、当社グループの業績に与える影響を最小化できる事業構造の構築に向けて、全社をあげて取り組んでまいります。

いずれにせよ、今後の業績への影響を最小限にとどめるべく、全力をあげてあらゆる施策を実行してまいります。

2012年3月期 業績見通しについて

続きまして、2012年3月期の業績見通しについて申し上げます。

2012年3月期 業績見通しについて

- **東日本大震災の発生により、当社グループの複数の生産拠点が被災したことに加え、震災の影響により当社グループを取り巻く市場環境の先行きが不透明な状況にあります。**
- **よって、現時点において合理的な業績予想の策定が困難な状況であることから、2012年3月期の連結業績予想値は開示しておりません。業績予想値につきましては、2011年7月を目処に公表する予定です。**
- **また、統合初年度の事業運営や東日本大震災の影響などをふまえた当社グループの今後の事業方針に関する説明会を、2011年7月初旬に開催する予定です。**

今までご説明させていただきましたとおり、東日本大震災の発生により、当社グループの複数の生産拠点が被災したことに加え、震災の影響により当社グループを取り巻く市場環境の先行きが不透明な状況にあります。

よって、現時点において合理的な業績予想の策定が困難な状況であることから、2012年3月期の連結業績予想値は開示しておりません。業績予想値につきましては、2011年7月を目処に公表する予定でございます。

また、統合初年度の事業運営や東日本大震災の影響などをふまえた当社グループの今後の事業方針に関する説明会を、2011年7月初旬に開催する予定です。

まとめ

まとめ

- **2011年3月期 通期における営業黒字を達成。**
- **100日プロジェクトで策定した構造対策プランは予定通り進捗。**
- **東日本大震災による業績への影響を最小限にとどめるべく、全力を挙げてあらゆる施策を実行。**

こちらが本日のまとめでございます。

まず、2011年3月期につきましては、合併初年度の目標でありました通期における営業黒字を達成いたしました。

また、「100日プロジェクト」で策定した構造対策につきましても、予定通り進捗しております。

最後に、繰り返しにはなりますが、東日本大震災の発生により、当社グループは那珂工場をはじめとして大きな被害を受けました。当社グループ一丸となった復旧作業および社外関係者の方々からの多大なるご支援により、被災したすべての工場において復旧のめどを立てることができました。この場をかりて、復旧にご尽力、ご支援いただいている、すべての方々に心より厚く御礼申し上げます。

今後も、お客様への製品供給の充足を最優先に取り組むとともに、震災による業績への影響を最小限にとどめるべく、全力を挙げてあらゆる施策を実行してまいります。

The logo for Renesas, featuring the word "RENESAS" in a stylized blue font with a small square icon to the left of the "R".

ルネサス エレクトロニクス株式会社

© 2011 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

2011年3月期 通期の決算概要のご説明は以上でございます。
本日は有難うございました。